

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003年8月7日 (07.08.2003)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/065429 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 21/205
(21) 国際出願番号: PCT/JP02/11772
(22) 国際出願日: 2002年11月12日 (12.11.2002)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願2002-17929 2002年1月28日 (28.01.2002) JP
(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会社
日鉱マテリアルズ (NIKKO MATERIALS CO., LTD.)
[JP/JP]; 〒105-8407 東京都 港区 虎ノ門二丁目 10番
1号 Tokyo (JP).
(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 佐々木 伸一
(SASAKI,Shinichi) [JP/JP]; 〒335-8502 埼玉県 戸田市
新曽南 3丁目 17番 35号 株式会社日鉱マテリ
- アルズ 戸田工場内 Saitama (JP). 中村 正志 (NAKA-MURA,Masashi) [JP/JP]; 〒335-8502 埼玉県 戸田市 新曾南 3丁目 17番 35号 株式会社日鉱マテリアルズ 戸田工場内 Saitama (JP). 佐藤 賢次 (SATO,Kenji) [JP/JP]; 〒335-8502 埼玉県 戸田市 新曽南 3丁目 17番 35号 株式会社日鉱マテリアルズ 戸田工場内 Saitama (JP).
(74) 代理人: 荒船 博司 (ARAFUNE,Hiroshi); 〒162-0832
東京都 新宿区 岩戸町 18番地 日交神楽坂ビル 5階
Tokyo (JP).
(81) 指定国(国内): CA, CN, KR, US.
(84) 指定国(広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。

(54) Title: GaN COMPOUND SEMICONDUCTOR CRYSTAL MAKING METHOD

(54) 発明の名称: GaN系化合物半導体結晶の製造方法

(57) Abstract: A method for growing a GaN compound semiconductor crystal on the surface of a substrate which is a rare-earth group XIII (IIIB) perovskite crystal containing one or more rare earth elements, wherein the thickness of the substrate is 250 μ m or less and the stress exerted by the substrate on the GaN thick-film crystal is decreased by the difference in the coefficient of thermal expansion.

(57) 要約:

1または2種類以上の希土類元素を含む希土類13(3B)族ペロブスカイト結晶を基板としてその表面にGaN系化合物半導体結晶を成長させる方法において、前記基板の厚さを250 μ m以下として、熱膨張率の差によりGaN厚膜結晶が基板から受ける応力が小さくなるようにした。

WO 03/065429 A1

明細書

GaN系化合物半導体結晶の製造方法

5 技術分野

本発明は、半導体素子の製造に用いられるGaN系化合物半導体結晶の製造方法に関し、GaN系化合物半導体結晶の成長工程において割れが発生するのを有効に防止する技術に関する。

10 背景技術

GaN、InGaN、AlGaN、InGaAlN等のGaN系化合物半導体($In_xGaN_yAl_{1-x-y}N$ 但し $0 \leq x, y ; x + y \leq 1$)は、発光デバイスやパワーデバイスなどの半導体デバイスの材料として期待され、またその他種々の分野で応用可能な材料として注目されている。

15 従来、GaN系化合物半導体のバルク結晶を成長させるのは困難であったため、上記電子デバイスには、例えばサファイア等の異種結晶上へのヘテロエピタキシーによってGaN等の薄膜単結晶を形成した基板が用いられていた。

ところが、サファイア結晶とGaN系化合物半導体結晶とは格子不整合性が大きいので、サファイア結晶上に成長させたGaN系化合物半導体結晶の転位密度が大きくなり結晶欠陥が発生してしまうという問題があった。さらに、サファイアは熱伝導率が小さく放熱しにくいので、サファイア結晶上にGaN系化合物半導体結晶を成長させた基板を消費電力の大きい電子デバイス等に用いると高温になりやすいという問題があった。

そこで、熱伝導率が大きくGaN系化合物半導体結晶と格子整合する基板の必要性が一層高まり、ハイドライド気相成長法(以下、HYPEと略する)を利用したELO(Epitaxial lateral overgrowth)法等の研究が急速に進められた。ここでELO法とは、例えばサファイア基板上にマスクとなる絶縁膜を形成し、該絶縁膜の一部に開口部を設けて絶縁膜をマスクとし、露出しているサファイア基板面をエピタキシャル成長の種として結晶性の高いGaN系化合物半導体結晶

を成長させる方法である。この方法によれば、マスクに設けられた開口部内側のサファイア基板表面からGaN系化合物半導体結晶の成長が始まりマスク上に成長層が広がっていくので、結晶中の転位密度を小さく抑えることができ、結晶欠陥の少ないGaN系化合物半導体結晶を得ることができる。

5 しかし、ELO法により得られたGaN系化合物半導体結晶は熱歪みが大きいため、ウェハ製造工程のポリッシングによりサファイア基板を除去して単体のGaN系化合物半導体結晶ウェハを得ようとするとき、GaN系化合物半導体結晶ウェハが歪んでしまうという問題があった。

そこで本発明者等は、異種結晶基板材料の一つとして希土類13(3B)族ペロブスカイト結晶を用い、且つその{011}面または{101}面を成長面としてGaN系化合物半導体をヘテロエピタキシーによって成長させる方法を提案した(WO 95/27815号)。なお、ここでいう{011}面または{101}面とは、それぞれ(011)面、(101)面と等価な面の組を表す。

前記先願の成長技術によれば、例えば希土類13(3B)族ペロブスカイトの一つであるNdGaO₃を基板として、その{011}面または{101}面にGaNを成長させた場合、格子不整合を1.2%程度とすることができる。この格子不整合の値はサファイアやその代替品として用いられるSiCを基板とした場合の格子不整合の値に比較して極めて小さい。したがって、結晶中の転位密度が低くなるので結晶欠陥の少ないGaN系化合物半導体結晶を成長させることができる。

しかしながら、前記先願の成長方法を利用してNdGaO₃基板上にGaN結晶厚膜を成長させた場合、GaN結晶を成長させた後の降温過程において、NdGaO₃基板とGaN結晶厚膜との熱膨張率の差によりGaN結晶中に割れが生じるおそれがあるという問題が明らかになった。

25 本発明は、GaN系化合物半導体結晶の成長工程においてGaN結晶厚膜に割れが生じるのを有効に防止することができるGaN系化合物半導体結晶の成長方法を提供することを目的とする。

発明の開示

本発明は、上記目的を達成するために、1または2種類以上の希土類元素を含む希土類13(3B)族ペロブスカイト結晶を基板としてその表面にGaN系化合物半導体結晶を成長させる方法において、前記基板の厚さを250μm以下としたものである。すなわち、基板の厚さを薄くすることにより、GaN系化合物半導体結晶の厚膜を成長させた後の降温過程における基板側の膨張量を小さくして、熱膨張率の差によりGaN系化合物半導体結晶が基板から受ける応力が小さくなるようにした。これにより、割れのない高品質なGaN系化合物半導体結晶を効率的に製造することができる。

例えば、NdGaO₃を基板として、その表面にGaN結晶を成長させる場合、10 厚さが250μm以下のNGO基板を用いたときは、GaN結晶厚膜に割れが生じる確率は50%以下にすることができる。

また、基板の厚さを薄くするほど膨張量を小さくできるので、基板の厚さを薄くした方がGaN結晶厚膜に応力による割れが生じるのを防止するのに有効である。例えば、厚さが120μmの基板を用いることにより、GaN厚膜に割れが生じる確率をほぼ0%にすることができる。ただし、基板の扱い安さの面から基板の厚さは100μm以上とするのが望ましく、さらに望ましくは120μm以上とするのがよい。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の好適な実施の形態を、NdGaO₃結晶を基板としてGaN化合物半導体結晶を成長させる場合について説明する。

まず、NdGaO₃のインゴットをスライスして結晶成長用の基板とした。このとき、NdGaO₃基板の大きさは2インチ径で、厚さを120μmとした。

次に、鏡面研磨したNdGaO₃基板をアセトン中で5分間超音波洗浄を行い、25 続けてメタノールで5分間超音波洗浄を行った。その後、N₂ガスでブローして液滴を吹き飛ばしてから自然乾燥させた。次に、洗浄したNdGaO₃基板を硫酸系エッチャント(磷酸：硫酸=1:3、80°C)で5分間エッチングした。

次に、このNdGaO₃基板をハイドライドVPE装置内の所定の部位に配置した後、N₂ガスを導入しながら基板温度を620°Cまで昇温し、GaNメタルと

H C 1 ガスから生成されたG a C 1 と、NH₃ガスとをN₂キャリアガスを用いてNdGaO₃基板上に供給し、約100 nmのGaN保護層を形成した。NdGaO₃は800°C以上の高温でNH₃やH₂と反応してネオジウム化合物を生成してしまうので、本実施形態ではキャリアガスとしてN₂を用い、620°Cの低温で保護層を形成することによりネオジウム化合物が生成されないようにしている。

次に、基板温度を1000°Cに昇温し、GaNメタルとH C 1 ガスから生成されたGaNと、NH₃ガスとをN₂キャリアガスを用いてNdGaO₃基板上に供給した。このとき、GaN分圧が 5.0×10^{-3} atm、NH₃分圧が 3.0×10^{-1} atmとなるようにそれぞれのガス導入量を制御しながら約40 μm/hの成長速度で300分間GaN化合物半導体結晶を成長させた。

その後、キャリアガスをN₂ガスからH₂ガスに切り替え、ガス分圧がH₂ 90%、NH₃ 10%となるように調整して、11時間熱処理を行った。この熱処理により厚さ350 μmのNdGaO₃基板を還元分解してすべて除去することができた。

その後、冷却速度5.3°C/minで90分間冷却して、2インチ径で、膜厚約600 μmの割れのないGaN厚膜結晶を得ることができた。

さらに、2インチ径で、厚さ120 μmのNdGaO₃基板を用いて、繰り返しGaN厚膜結晶を成長させたところ、結晶成長後の冷却工程における割れの発生確率はほぼ0%であった。

一方、従来のGaN厚膜結晶の製造に用いられていた2インチ径で、厚さ370 μmのNdGaO₃基板を用いてGaN厚膜結晶を成長させた場合は、結晶成長後の冷却工程における割れの発生確率は約90%であった。

また、本実施例で得られたGaN厚膜結晶の面方位を制御し、さらに鏡面加工を施して、例えば厚さ350 μmに加工して半導体素子用の基板とすることにより、素子特性に優れた半導体素子を製造することができた。

以上、本発明者によってなされた発明を実施形態に基づき具体的に説明したが、本発明は上記実施の形態に限定されるものではない。基板として用いられる希土類13(3B)族ペロブスカイト結晶はNdGaO₃結晶に制限されず、例えば、

NdAlO₃, NdInO₃等を用いることができる。

また、GaN系化合物半導体結晶の成長条件としては、GaN 1分圧が $1 \cdot 0 \times 10^{-3} \sim 1 \cdot 0 \times 10^{-2}$ atm、NH₃分圧が $1 \cdot 0 \times 10^{-1} \sim 4 \cdot 0 \times 10^{-1}$ atm、成長速度が $30 \sim 100 \mu\text{m}/\text{h}$ 、成長温度が $930 \sim 1050^{\circ}\text{C}$ 、冷却速度が $4 \sim 10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ であることが望ましい。

本発明によれば、1または2種類以上の希土類元素を含む希土類13(3B)族ペロブスカイト結晶(例えば、NdGaO₃)を基板としてその表面にGaN系化合物半導体結晶を成長させる方法において、前記基板の厚さを $250 \mu\text{m}$ 以下として、熱膨張率の差によりGaN厚膜結晶がNGO基板から受ける応力を小さくなるようにしたので、GaN厚膜結晶に割れが生じるのを防止でき、生産効率が向上するという効果を奏する。

産業上の利用可能性

本発明は、GaN化合物半導体結晶の成長に制限されず、例えば、InGaN、AlGaN等のその他のGaN系化合物半導体結晶を成長させる場合に利用できる。

請求の範囲

1. 1または2種類以上の希土類元素を含む希土類13(3B)族ペロブスカイト結晶を基板としてその表面にGaN系化合物半導体結晶を成長させる方法において、

前記基板の厚さを250μm以下とすることを特徴とするGaN系化合物半導体結晶の製造方法。

2. 前記希土類13(3B)族ペロブスカイト結晶基板は、NdGaO₃結晶であることを特徴とする請求項1に記載のGaN系化合物半導体結晶の製造方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP02/11772

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H01L21/205

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H01L21/205

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

| | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Jitsuyo Shinan Koho | 1922-1996 | Toroku Jitsuyo Shinan Koho | 1994-2002 |
| Kokai Jitsuyo Shinan Koho | 1971-2002 | Jitsuyo Shinan Toroku Koho | 1996-2002 |

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|-----------|--|-----------------------|
| X | JP 2000-269143 A (Japan Energy Corp.), 29 September, 2000 (29.09.00), Full text (Family: none) | 1,2 |
| Y | US 5716450 A (Japan Energy Corp.), 19 October, 1995 (19.10.95), Full text; all drawings & WO 95/27815 A & EP 711853 A | 1,2 |
| Y | JP 2000-12901 A (Japan Energy Corp.), 14 January, 2000 (14.01.00), Full text (Family: none) | 1,2 |

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

| | | |
|---|-----|--|
| * Special categories of cited documents: | "T" | later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention |
| "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance | "X" | document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone |
| "E" earlier document but published on or after the international filing date | "Y" | document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art |
| "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) | "&" | document member of the same patent family |
| "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means | | |
| "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed | | |

Date of the actual completion of the international search
28 January, 2003 (28.01.03)

Date of mailing of the international search report
12 February, 2003 (12.02.03)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP02/11772

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|-----------|---|-----------------------|
| Y | JP 2000-4045 A (Japan Energy Corp.), 07 January, 2000 (07.01.00), Full text (Family: none) | 1,2 |
| Y | JP 8-208385 A (Japan Energy Corp.), 13 August, 1996 (13.08.96), Full text (Family: none) | 1,2 |

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int.Cl' H01L21/205

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl' H01L21/205

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

| | |
|-------------|------------|
| 日本国実用新案公報 | 1922-1996年 |
| 日本国公開実用新案公報 | 1971-2002年 |
| 日本国登録実用新案公報 | 1994-2002年 |
| 日本国実用新案登録公報 | 1996-2002年 |

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
|-----------------|--|------------------|
| X | JP 2000-269143 A (株式会社ジャパンエナジー) 2000. 09. 29, 全文 (ファミリーなし) | 1, 2 |
| Y | US 5716450 A (株式会社ジャパンエナジー) 1995. 10. 19, 全文, 全図 & WO 95/27815 A & EP 711853 A | 1, 2 |
| Y | JP 2000-12901 A (株式会社ジャパンエナジー) 2000. 01. 14, 全文 (ファミリーなし) | 1, 2 |

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す)
 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」同一パテントファミリー文献

| | |
|---|--|
| 国際調査を完了した日 28. 01. 03 | 国際調査報告の発送日 12. 02. 03 |
| 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号 100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 | 特許庁審査官(権限のある職員) 土屋 知久 電話番号 03-3581-1101 内線 3469 4R 8826 |

C (続き) . 関連すると認められる文献

| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
|-----------------|---|------------------|
| Y | JP 2000-4045 A (株式会社ジャパンエナジー) 2000. 01. 07, 全文 (ファミリーなし) | 1, 2 |
| Y | JP 8-208385 A (株式会社ジャパンエナジー) 1996. 08. 13, 全文 (ファミリーなし) | 1, 2 |